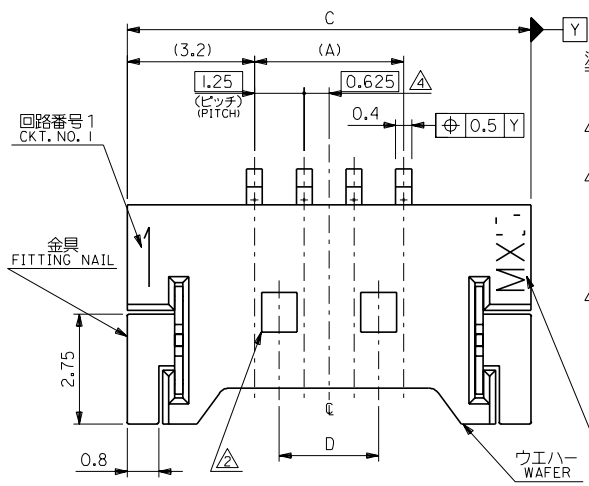
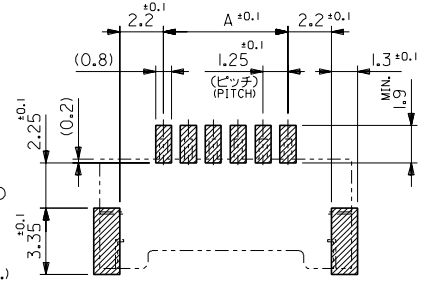


DWG. NO. SD-53780-**-IO
回路番号 1
CKT. NO. 1
F
E
D
C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

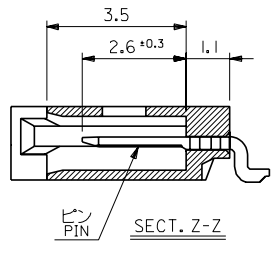
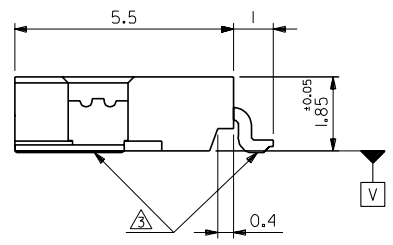
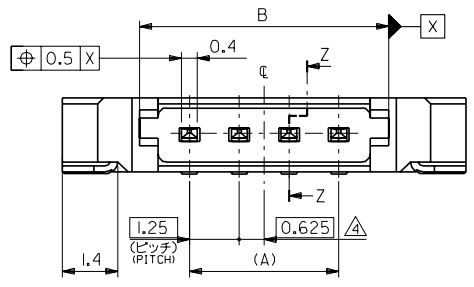


注記 NOTES

1. 嵌合相手：51146 シリーズ
MATES WITH : 51146 SERIES
2. ロック窓は2、3極品は1箇所、4極品以上は2箇所とする。
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CIRCUIT PRODUCTS AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CIRCUIT PRODUCTS.
3. 基準面 [V] からの溶剤テールと金具の半田付け面のズレ量は、上方向に 0.05MAX.、下方向 0.15MAX. とし、20 極以下の相互のバラツキ量は 0.1MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL AND FITTING NAIL FROM [V] : UPPER DIRECTION 0.05MAX. : LOWER DIRECTION 0.15MAX. : OFFSET BETWEEN UPPER AND LOWER 0.1MAX. (UNDER 20 CKTS.)
4. 偶数極の製品に適用。
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
5. 材質 MATERIAL
ウエハー WAFER : PPHS , UL94V-0
ピン : リン青銅 (コンタクト部 : 金メッキ、テール部 : 半田メッキ)
PIN : PHOS-BRO (CONTACT : Au PLATING, TAIL : Sn-Pb PLATING)
金具 : リン青銅 (半田メッキ)
FITTING NAIL : PHOS-BRO (Sn-Pb PLATING)



参考基板レイアウト
RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN DIM. (REF.)



8.75	22.5	30.15	26.27	23.75	53780-2010	20
7.5	20	27.65	23.77	21.25	↑	-1810 18
6.25	17.5	25.15	21.27	18.75	↑	-1610 16
6.25	16.25	23.9	20.02	17.5	↑	-1510 15
5	15	22.65	18.77	16.25	↑	-1410 14
3.75	12.5	20.15	16.27	13.75	↑	-1210 12
2.5	10	17.65	13.77	11.25	↑	-1010 10
2.5	8.75	16.4	12.52	10	↑	-0910 9
1.25	7.5	15.15	11.27	8.75	↑	-0810 8
1.25	6.25	13.9	10.02	7.5	↑	-0710 7
—	5	12.65	8.77	6.25	↑	-0610 6
—	3.75	11.4	7.52	5	↑	-0510 5
—	2.5	10.15	6.27	3.75	↑	-0410 4
—	—	8.9	5.02	2.5	↑	-0310 3
—	—	7.65	3.77	1.25	↑	53780-0210 2
E	D	C	B	A	ENG. NO.	CKT. 極数

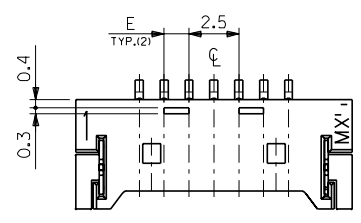
角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISD	LC2000-0862	S.M.	T.Y.	00/6/21
30 以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISD	LC808231	S.M.	S.K.	98/4/22
10 以上 未過	±0.25	A	変更 REVISD	LC706449	S.M.	Y.M.	97/1/21
10 未過	±0.2	O	新規作成 PROPOSED	LC605410	S.M.	H.H.	96/8/9
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 I.T.R	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	モレックス MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	REVISION ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
被覆外径 INS. RANGE	—	1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T.
DRAWN BY '95/2/29	CHK'D BY '00/6/21	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
Y.MIZUNO	T.YAMAGUCHI	SD-53780-**-IO
APP'D BY '00/6/21	尺度 M.FUKUSHIMA	SCALE —

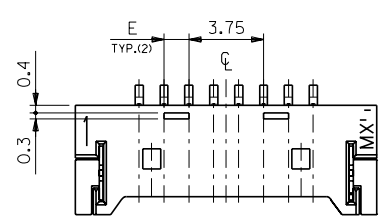
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C1032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53780-**-10
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

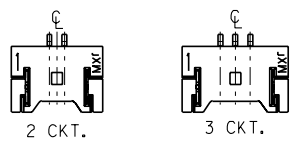
8 7 6 5 4 3 2 1



7~19極の奇数極に適用
 APPLY FOR ODD CIRCUITS OF 7~19



8~20極の偶数極に適用
 APPLY FOR EVEN CIRCUITS OF 8~20



ロック形状図
 LOCK CONFIGURATION

G	変更 REVISED	LC2000-0862)	S.M. T.Y.	10/16/21	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
F	変更 REVISED	LC80823)	S.M. S.K.	9/14/22		
E	変更 REVISED	LC70644)	S.M. Y.M.	9/11/21	仕上げ FINISH	—
D	変更 REVISED	LC70592)	S.M. Y.M.	9/11/21	適用電線範囲 WIRE RANGE	—
C	変更 REVISED	LC70159)	S.M. Y.M.	9/8/19	被覆外径 INS. RANGE	—
B	変更 REVISED	LC60804)	S.M. M.F.	9/5/11	DRAWN BY '95/12/29	CHK'D BY '00/6/21
A	変更 REVISED	LC60541)	S.M. H.H.	9/2/16		
O	新規作成 PROPOSED	LC60428)	Y.M. H.H.	9/12/15	APP'D BY '00/6/21	尺度 SCALE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 L.T.R.	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	M.FUKUSHIMA	—

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T.
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53780-**-10 G	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C1032)MXJ-32

8 7 6 5 4 3 2 1